

RJ45C6 R1V 3.2N4N TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



本製品のラインナップは、下記設計を網羅しています：

- 90アングル（水平）および180ストレート（垂直）
- ラッチアップ/ラッチダウン
- THT、THR、SMDはんだプロセス
- 幅広いデザインタイプ、LED内蔵、シールドタブ付き
- パフォーマンスカテゴリ3 から Cat. Cat.6。
- トレイ包装（TY）またはテープ・オン・リール（RL）
- ANSI / TIA-1096-AおよびIEC 60603に準拠したモジュラーRJ45コネクタに対応
- 絶縁耐力 ≥ 1500 V AC RMS（2250 V AC ピーク値）、IEEE 802.3 準拠
- IEC 60603に準拠した絶縁耐力 ≥ 1500 V AC（ピーク値）または ≥ 1500 V DC

特性と長所：

- 最大性能に対応する - 40°C から + 85°C の温度範囲拡張
- 30 μ m 金メッキで耐腐食性を強化
- 0.3mm 以上のスタンドオフによる最適なはんだ付け加工

一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ, RJ45ジャック, Cat. 6, THT/THRはんだ接続, 180°, LED: いいえ, 極数: 8, トレイ（手動式アセンブリ）
注文番号	2634590000
種別	RJ45C6 R1V 3.2N4N TY
GTIN (EAN)	4050118651270
数量	140 Stück
パッケージ	トレイ（手動式アセンブリ）

RJ45C6 R1V 3.2N4N TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	16.7 mm	奥行き (インチ)	0.657 inch
高さ	16.5 mm	高さ (インチ)	0.65 inch
幅	16 mm	幅 (インチ)	0.63 inch
正味重量	7.475 g		

システム仕様

LED	いいえ	PCB の取り付け	THT/THRはんだ接続
はんだピン位置の公差	0.1 mm	はんだピン寸法	八角形
はんだ付け工程	リフローハンダ付け, 手動 はんだ付け, フローはんだ 付け	カテゴリ	Cat. 6
シールド	はい	シールド面	ニッケルメッキ
ソルダーピン長 (l)	3.2 mm	ピッチ (mm) (P)	1.27 mm
ピッチ (インチ) (P)	0.05 "	プラグング回数	750
保護度合い	IP20	外向きエルボ	180°
性能カテゴリ	Cat. 6	接続方式	はんだ接続
極数	8	製品ファミリー	データの最小化 - RJ45モ ジュラージャック

電気プロパティ

PoE / PoE+	IEEE 802.3atに適合	定格電圧	125 V
絶縁耐性	≥ 500 MΩ	耐電圧、接点 / シールド	1500 V DC
耐電圧、接点 / 接点	1000 V DC		

材料データ

絶縁材	PA 9T	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	絶縁耐性	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	UL 94 可燃性等級	V-0
接点材質	銅合金	接触表面	ニッケル下地金メッキ
動作温度、最小	-40 °C	動作温度、最大	80 °C

梱包

パッケージ	トレイ (手動式アセンブ リ)	VPE 長	317 mm
VPE幅	188 mm	VPEの高さ	68 mm

分類

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/07/04 7:07:32 CEST

RJ45C6 R1V 3.2N4N TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Certificate of Compliance
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

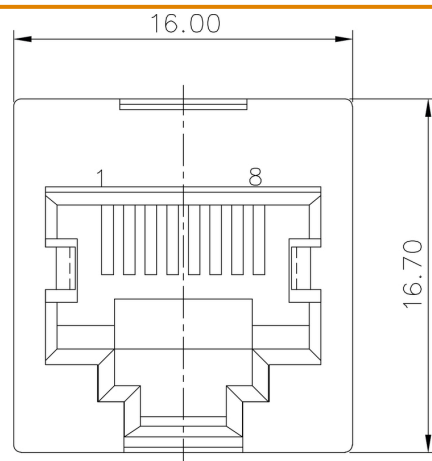
RJ45C6 R1V 3.2N4N TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

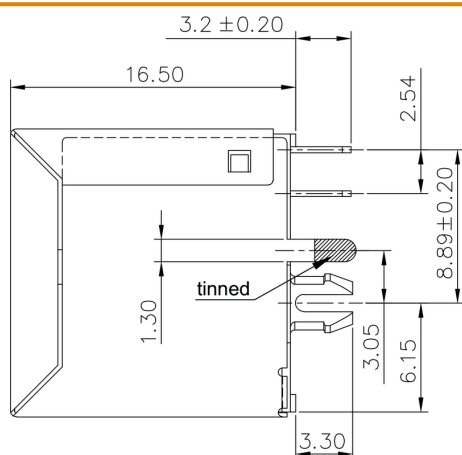
www.weidmueller.com

図面

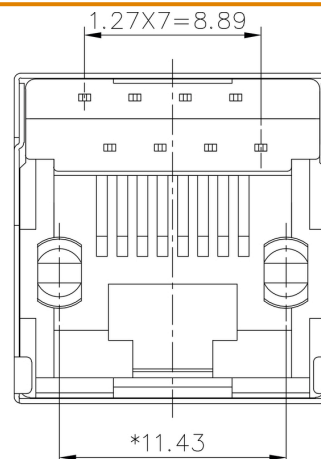
寸法図



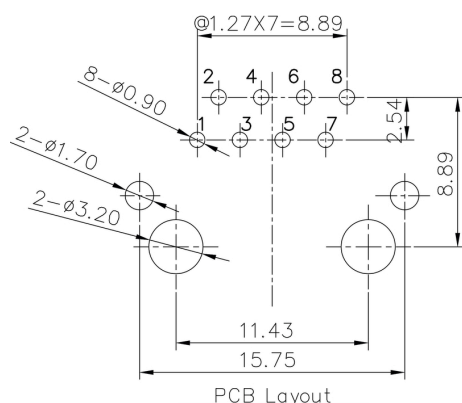
寸法図



寸法図



PCB設計



RJ45C6 R1V 3.2N4N TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



RJ45	G1	R	1	U	3.2	E	4	GY/GY	TY	RJ45G1 R1U 3.2E4GY/GY TY
</										

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260 °C . In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.